

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2025 年 10 月 9 日-10 月 17 日)

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐专场机构交流会 ☐其他 _____ ☐分析师会议 ☐业绩说明会 ☐路演活动 ☐现场参观
参与单位名称及人员姓名	泰康资产 李晓金、泰康资产 张永兴、泰康资产 王嘉艺、泰康资产 邹志、泰康资产 余思雨、长江证券 杨洋、长江证券 张梦杰、长江证券 李佩霖、广发基金 吴若飞、广发基金 蒋科、广发基金 傅友兴、广发基金 贾乃鑫、广发基金 代振华、广发基金 观富钦、广发基金 曹越、广发基金 郑澄然、广发基金 王辰昊、广发基金 刘彬、广发基金 赵古月、广发基金 刘玉、广发基金 苏文杰、华泰证券 谢春生、华泰证券 张皓怡、华泰证券 林文富、平安证券 徐勇、平安证券 郭冠君、汇添富 钱晨润、国泰基金 孙家旭、兴业证券 张元默、鹏华基金 萧嘉倩、华福证券 郑超君、申万菱信 徐巡、中汇（北京）私募基金 刘新、中汇（北京）私募基金 刘志强、财通资管 李晶、交银施罗德 周珊珊、平安基金 蔡锐帆、华源证券 何理、华源证券 葛星甫、中邮证券 徐秋如、高旗资本 喻忠杰、个人投资者 鲁正轩、个人投资者 高炜骏、个人投资者 吴良波
会议时间	2025 年 10 月 9 日 15：00-16：00 2025 年 10 月 14 日 10：30-11：30 2025 年 10 月 15 日 15：00-16：00 2025 年 10 月 16 日 15：30-16：30 2025 年 10 月 17 日 14：00-15：00
会议地点	佰维存储三楼会议室 西丽湖人才服务中心 T2 会务空间
上市公司接待人员姓名	公司管理层 董办工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	Q1. 公司有哪些产品可以满足 AI 时代的存储产品需求？ A1: 公司在 AI 端侧领域通过自研主控芯片、固件算法与先进封测能力实现差异化竞争，覆盖 AI 手机、AI PC、AI 眼镜、具身智能等多场景。公司面向 AI 手机已推出 UFS、LPDDR5/5X、uMCP 等嵌入式存储产品，并已量产 12GB、16GB 等大容量 LPDDR5X 产品，最高支持 8,533Mbps 传输速率，公司是少数除原厂之外可以提供该规格产品的存储解决方案厂商。公司面向 AI PC 已推出高端 DDR5 超频内存条、PCIe 5.0 SSD 等高性能存储产品。在智能可穿戴领域，公司 ePOP 系列产品目前已被应用于智能手表、智能眼镜等智能穿戴设备上。此外，公司在 AI 教育、AI 翻译等 AI 端侧领域布局行业领先。2024 年公司 AI 新兴端侧领域营收超过 10 亿元，同比增长约 294%。在企业级领域，公司面向 AI 服务器打造了完善的企业级存储解决方案，已推出 CXL 内存、PCIe SSD、SATA SSD、及 RDIMM 内

	存条等产品线。 Q2. 公司如何看待当前存储行业的价格上涨及持续性？ A2: NAND Flash 方面，TrendForce 集邦咨询预测产品价格将在 2025 年第四季度继续上涨 5-10%。DRAM 方面，TrendForce 集邦咨询预测一般型 DRAM 价格在 2025 年第四季度继续上涨 8-13%。目前存储价格持续回升，叠加传统旺季的备货动能，以及 AI 眼镜等新兴应用需求旺盛，从当前时点来看，景气度仍会持续。 Q3. 公司晶圆级先进封测项目可满足哪些应用需求？ A3: 公司的晶圆级先进封测项目已构建覆盖 Bumping、Fan-in、Fan-out、RDL 等晶圆级先进封装技术，目前主要规划两大类产品线，分别是应用于先进存储芯片的 FOMS 系列，以及先进存算合封 CMC 系列，可以满足新时代对大容量存储和存算合封的需求，主要适用于 AI 端侧（AI PC、具身智能、AR/VR 眼镜）、AI 边缘（智能驾驶等）领域。 Q4. 公司自研主控芯片有哪些竞争优势？如何适配下游终端应用？ A4: 公司首款主控芯片 SP1800 eMMC 5.1 实现多项国产突破，已成功量产，性能优异，目前已送样国内某头部客户，实测关键指标性能和功耗满足客户需求。在智能穿戴应用方面，SP1800 在性能和功耗方面进行了优化，并可实现定制化调整，其解决方案受核心客户认可；在手机应用方面，SP1800 支持 TLC 及 QLC 颗粒，迎合手机存储 QLC 替代趋势，其解决方案将于 2025 年量产；在车规应用方面，SP1800 提供端到端数据保护，适合车规宽温应用场景，其解决方案受核心客户认可。公司在芯片设计领域持续加大研发力度，专注于自研 LDPC 纠错算法、高性能架构以及低功耗技术的研发，致力于构建主控核心技术平台。基于该平台，公司积极推进 UFS 主控芯片等关键领域，围绕功耗、性能、可靠性等核心指标，努力打造行业领先的、具备高度竞争力的主控能力，为提升存储解决方案的核心竞争力提供坚实保障。 Q5. 为抓住 AI 端侧市场机遇，公司在主控芯片、固件算法和先进封装等核心领域有哪些布局和技术储备？ A5: AI 端侧场景要求存储产品具有高性能、低功耗的特性，过去的存储产品主要通过固件来优化性能，未来要通过主控芯片设计、固件算法与先进封装能力实现差异化竞争。在主控芯片设计方面，公司积极布局芯片研发与设计领域，将采用业界领先的架构设计，提升公司在 AI 手机、AI 穿戴、AI 智驾等领域的高端存储解决方案的产品竞争力；在固件算法方面，公司全面掌握了存储固件核心技术，有能力匹配各类客户典型应用场景，为客户提供创新、优质的存储解决方案；在先进封装方面，公司已掌握 16 层叠 Die、30~40μm 超薄 Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力，达到国际一流水平，并构建 Bumping、RDL、Fan-out 等晶圆级先进封装能力。通过主控芯片设计、固件算法与先进封装的协同效应，公司的存储解决方案实现行业领先的产品创新能力和可靠性，能够持续为终端客户提供适合 AI 端侧场景的高性能、低功耗的存储器产品。 Q6. 公司产品应用领域广泛，各应用领域分别有哪些下游客户？ A6: 在手机领域，公司实现了一线手机客户的持续突破，2025 上半年突破 vivo，
--	---

	与 OPPO、传音、摩托罗拉等客户持续保持深度合作；在 PC 领域，公司实现了全球头部 PC 客户预装市场的进一步突破，新进入小米，与联想、Acer、HP、同方等国内外知名 PC 厂商持续合作，此外，公司在消费级 PC 市场表现持续亮眼，收入持续增长；在 AI 端侧领域，公司产品目前已被 Meta、Google、小米、小天才、Rokid、雷鸟创新等国内外知名企业应用于其 AI/AR 眼镜、智能手表等智能穿戴设备上，2025 年上半年 Meta 仍是公司出货量最大的 AI 眼镜客户，公司为其提供 ROM+RAM 存储器芯片，是国内的主力供应商；在企业级领域，公司产品目前正处于高速发展阶段，已获得 AI 服务器厂商、头部互联网厂商以及国内头部 OEM 厂商的核心供应商资质，并实现预量产出货，同时积极深化国产化生态布局，与国产服务器厂商达成战略合作伙伴关系；在智能汽车领域，公司已向头部车企大批量交付 LPDDR 和 eMMC 产品，并且持续推动新产品导入验证。
附件清单	无
日期	2025 年 10 月 9 日-10 月 17 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。